

厂家生产电脑主机卡板盲孔BGA沉金电路板

产品名称	厂家生产电脑主机卡板盲孔BGA沉金电路板
公司名称	东莞市荃虹电子有限公司
价格	1000.00/平方米
规格参数	阻焊:綠油 材质:FR-4 表面处理:沉金
公司地址	广东省东莞市常平镇常平大道志兴1001
联系电话	0769-83556180 18948610498

产品详情

荃虹电子专业从事pcb/fpc制造10年以上的台湾厂,可提供设计、抄板、改板等服务.主要以双面及多层(1-6) osp、镀镍、無鹵素(有铅和无铅)喷锡、沉金等以及厚铜、厚金、阻抗、金手指等特殊生产工艺;提供超值的服务(七星级服务)為我们的目标.

表面工艺处理:热风整平、模冲、数字v割、铣床成型 喷铅锡、喷环保锡/无铅锡、电镀镍、电金/化学沉金/化金、化学沉银/化银、金手指、抗氧化/osp/印助焊剂、碳桥/碳手指、碳灌孔
制作层数:单面,双面,四层 最大加工面积:单面:800mm × 450mm;双面:580mm × 580mm;
板厚:最薄:0.4mm;最厚:3.0mm 最小线宽线距:最小线宽:0.15mm;最小线距:0.2mm
最小焊盘及孔径:最小焊盘:0.8mm;最小孔径:0.4mm 金属化孔孔径公差:pth hole dia.tolerance 直径 $0.8 \pm 0.05\text{mm}$ > 直径 $0.8 \pm 0.10\text{mm}$ 孔位差: $\pm 0.05\text{mm}$
抗电强度与抗剥强度:抗电强度: 1.6kv/mm;抗剥强度:1.5v/mm 阻焊剂硬度: > 5h 热冲击:288 10ses 燃烧等级:94v0防火等级 可焊性:235 3s在内湿润翹曲度 $t < 0.01\text{mm/mm}$
离子清洁度 < 1.56微克/平方厘米 基材铜箔厚度:1/3oz、1/2oz、1/1oz、h/hoz、1oz、2oz、3oz
电镀层厚度:镍厚5-30um 金厚0.015-0.75um

可靠性测试:开/短路测试、阻抗测试等采用飞针测试,测试架测试

阻焊颜色:绿色、黑色、蓝色、白色、红色、黄色、紫色等

字符颜色:白色、黑色等

v割:角度:30度、35度、45度 深度:板厚2/3 常用基材:普通纸板:94hb(普通纸板,不防火)、94v0(阻燃纸板,防火)、fr-1(防火)、fr-2(防火)、防火玻纤板材:22f(半玻纤)、cem-1(半玻纤)、cem-3(双面半玻纤)、fr-4(全玻纤)、铝基板、高频板。